

# elexcon

## 深圳国际电子展



# 展后报告

2023年8月23-25日

深圳会展中心（福田）1/9号馆

参展请联系

电话：0755-88311535

邮箱：elexcon.sales@informa.com

更多展会详情请登录

[www.elexcon.com](http://www.elexcon.com)

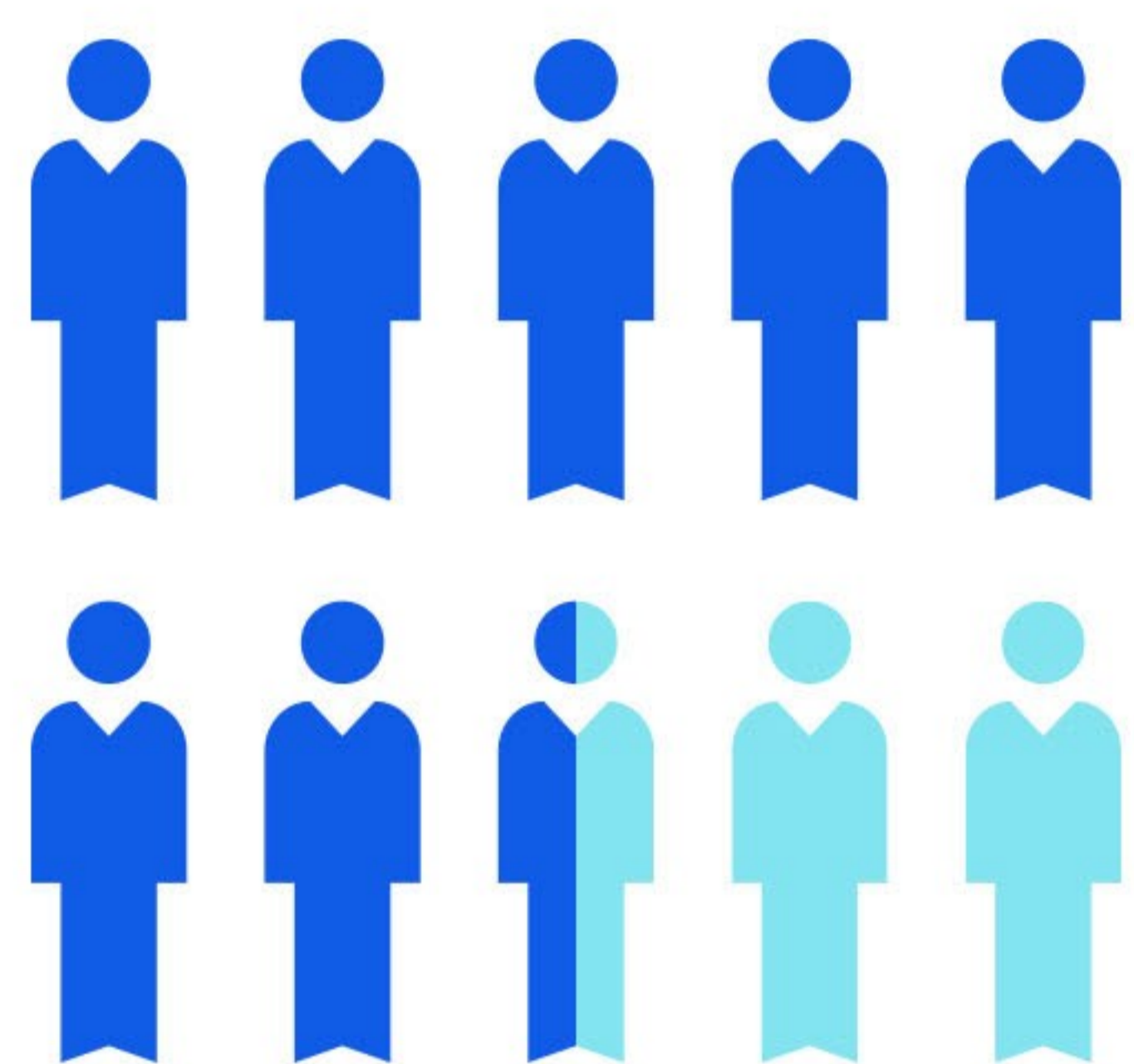


关注elexcon官方公众号





## 展览数据

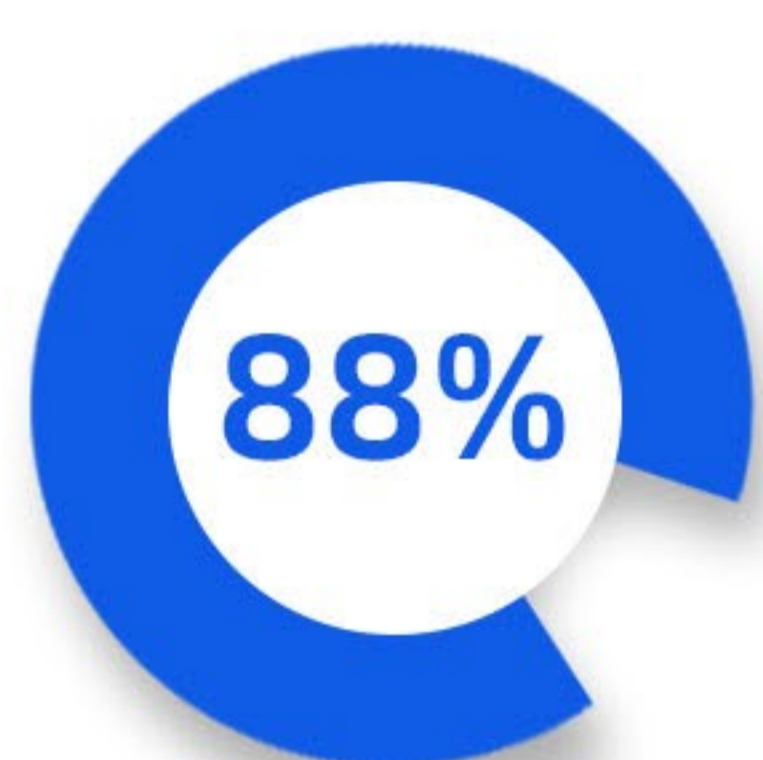


**72,389名**  
专业观众

**545家**  
展商数量

**45,000m<sup>2</sup>**  
展览面积

## 展商分析



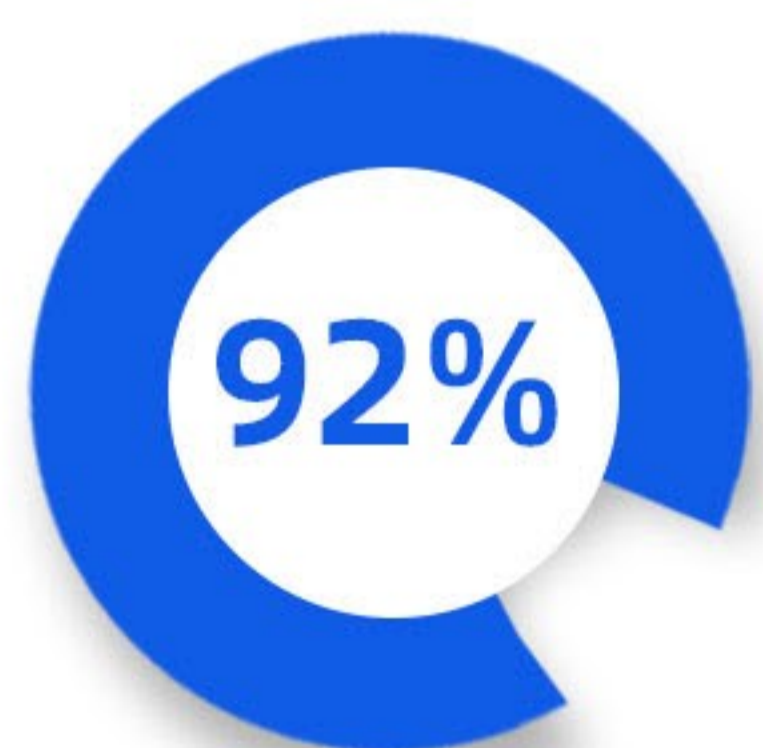
展商对本届elexcon的满意度



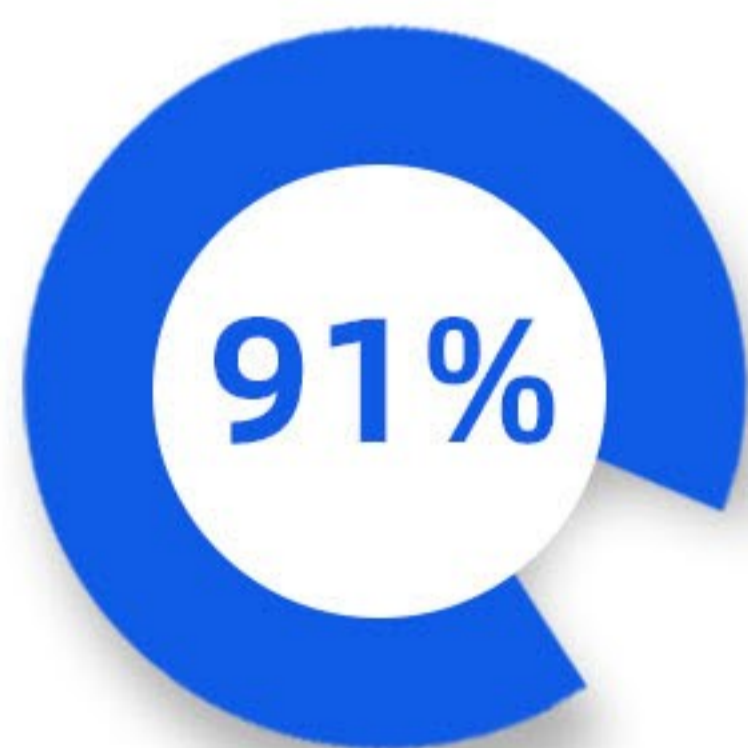
展商愿意继续参加下一届展会



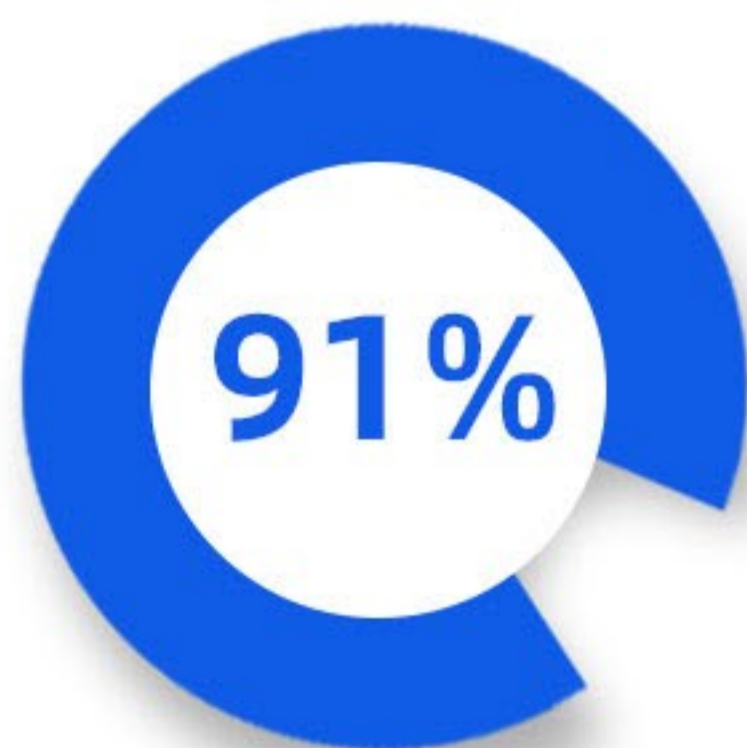
展商推荐本展览的可能性



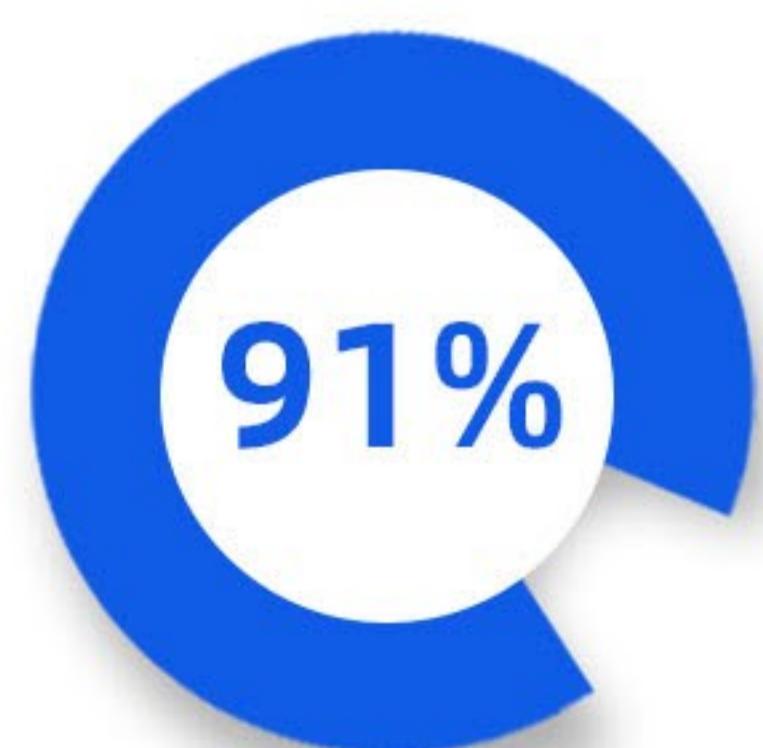
寻找新买家



寻找特许经营合作伙伴



开拓新市场



推出新产品



建立品牌形象



巩固与买家/伙伴的联系





## 展商评语



慧智微成立于2011年，是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端芯片的设计公司，主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售。本次展会现场展示了5G可重构的射频前端最新开发进展、消费类/工业类/车载类射频前端最新应用、未来射频前端技术演进等最新射频技术与射频产品，吸引了众多观众和行业展商前来进行友好的交流洽谈。常感谢elexcon电子展的平台，祝愿活动越办越好！

慧智微



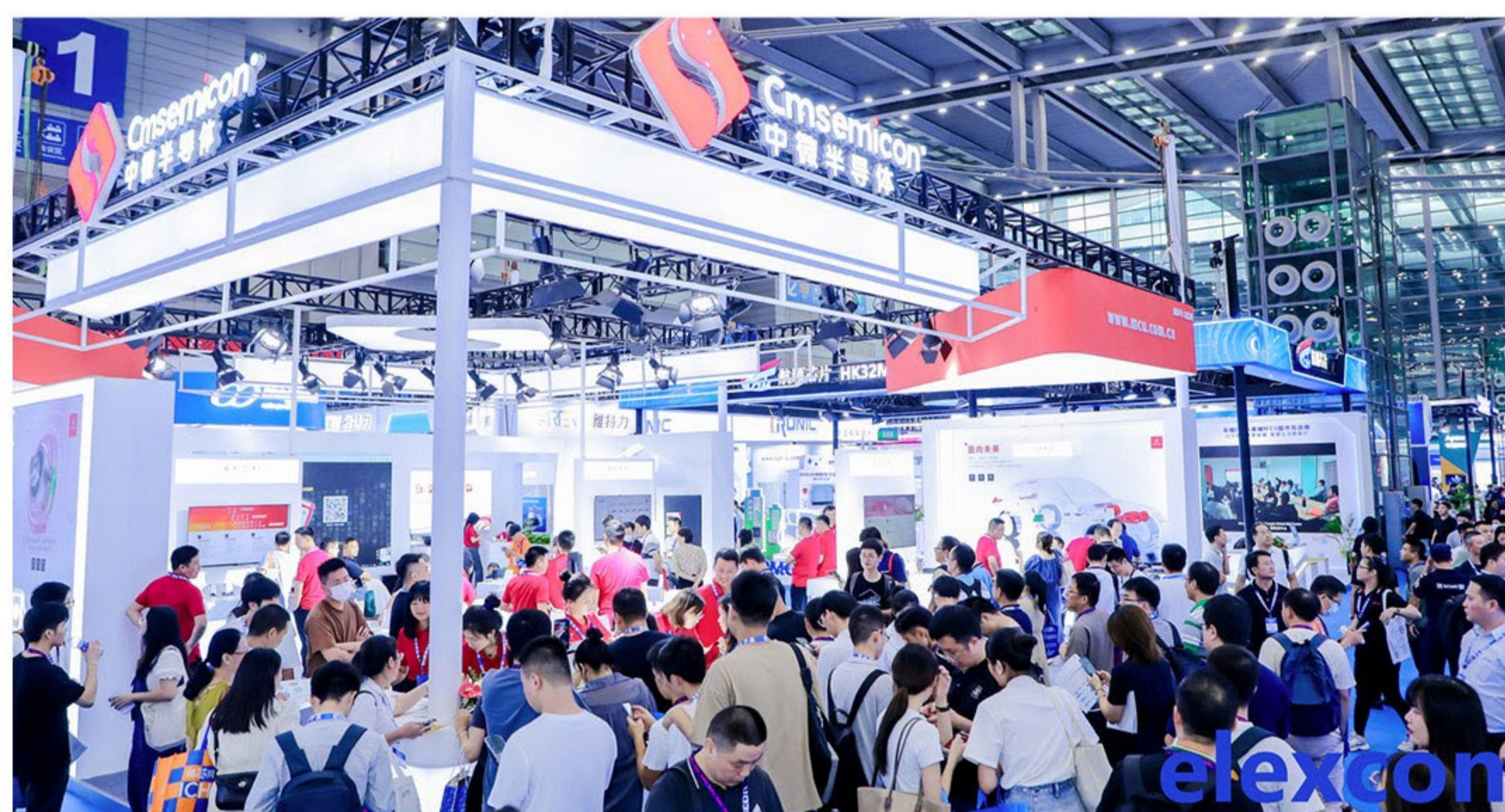
此次展会国芯科技携领先的汽车电子芯片、云-边-端信息安全芯片及模组、RAID卡等系列产品亮相，充分展现了国芯科技在国产芯片行业内产品“覆盖更全、更具竞争力”的优势，以及领先的技术积累、科研实力与创新风采。展会的完美呈现离不开elexcon电子展提供的平台与周到的服务，祝愿elexcon电子展越办越好，期待明年继续相聚！

国芯科技



这次作为学术机构参加了elexcon展会并分享了SiC器件现状及国产化进展，和相关参会厂商进行深入的交流。整体上看，目前国内SiC半导体技术发展迅速，产业链大部分技术节点达到或接近国际同类水平，在光储冲领域的芯片国产替代已经大规模进行，新能源汽车用SiC芯片也处于导入前夜。期待展会进一步丰富会议报告的深度和广度，吸引更多产业链各4方企业参与，共同推动产业发展，elexcon展会越办越好！

复旦大学 特聘教授 张清纯



九峰山实验室  
JFS LABORATORY

作为共性技术平台对外合作服务商参加了elexcon举办的2023深圳国际电子展的展会，感谢主办方提供的展会平台，现场与多家芯片及设备厂家进行了交流，接收到了很多对半导体检测分析的客户需求。同时也聆听了多个专业的会议论坛讲座，对国内半导体相关的新设备和新技术有了更加深入的了解。期待后续更进一步与意向企业的对接交流，也期待后续能够继续参加此类活动。

九峰山实验室 检测中心总经理 刘宁宇



上海安路信息科技股份有限公司  
SHANGHAI ANLOGIC INFOTECH CO., LTD.

深刻感受到elexcon在华南具有重要的影响力，在本次展会上，安路科技向来自消费电子、工业控制、汽车电子等领域的参观者们展示了中国FPGA产品及最新的客户案例、解决方案，感谢elexcon提供的平台，期待未来有更多的展示机会！

安路科技





### 专业观众分析

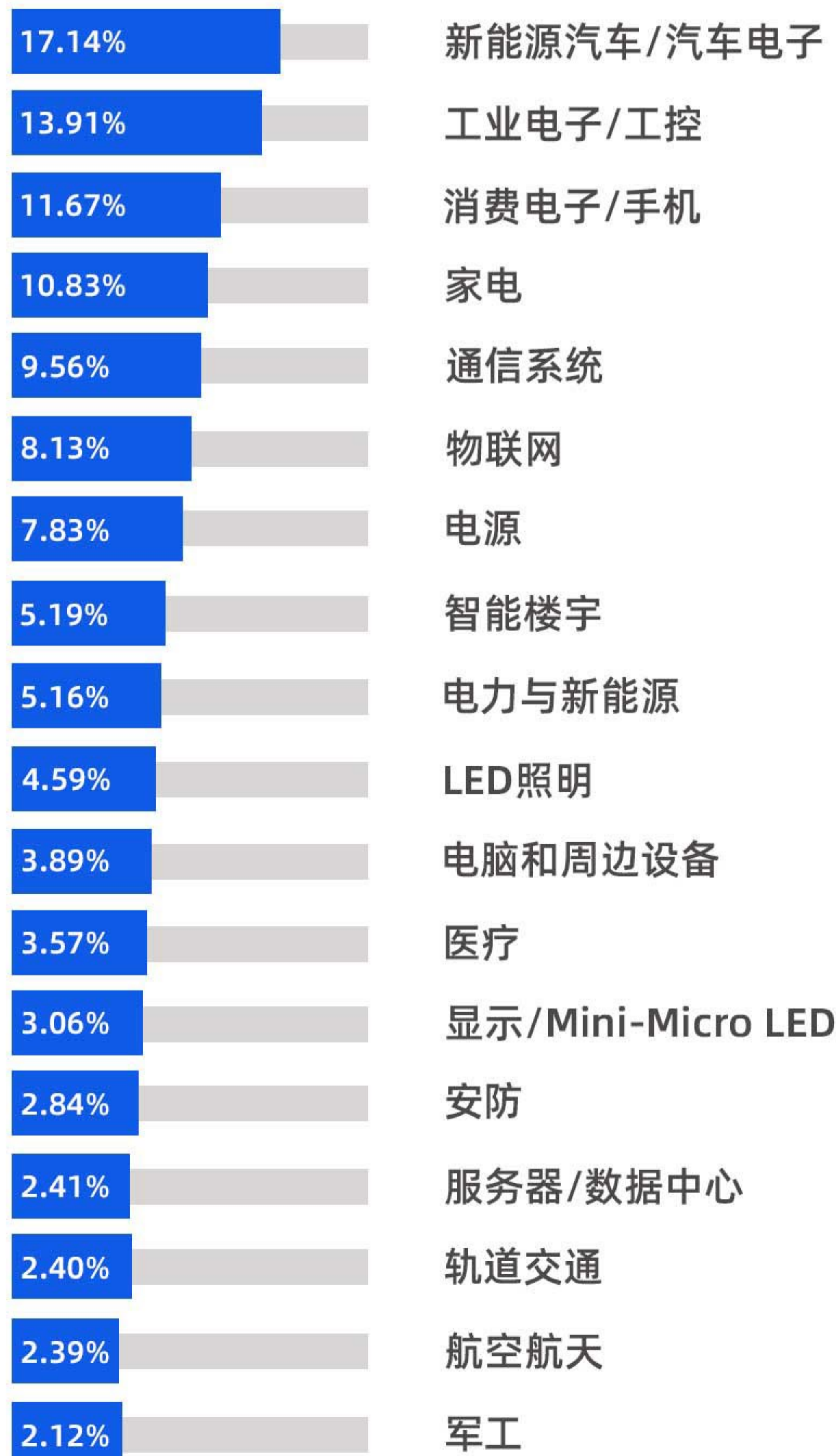
#### 观众所属部门



#### 观众所属企业性质



#### 观众所属行业



观众对本届elexcon的满意度



观众愿意继续参加下一届展会



观众推荐本展览的可能性

#### 采购决策权分析





## 买家评语

这次作为工艺技术人员参加elexcon举办的第七届中国系统级封装大会·深圳站的大会及展会，现场参观了解了多家半导体设备厂商的先进设备及聆听了多位行业大咖的专业论坛讲座，了解了一些行业的新设备、新技术，受益匪浅，后续会进一步进行设备和工艺技术的对接。感谢主办方提供的平台，期待后面可以继续参加此类活动。

### 惠州市德赛西威汽车电子有限公司 程赞华

这次作为采购商参加elexcon与OE汽车联合举办的采供对接会，见到了5家连接器供应商，整体谈下来资质都不错，后续会继续对接，感谢主办方提供的大规模平台。另外在现场也了解到很多优质展商，期待后面可以继续参加此类活动。

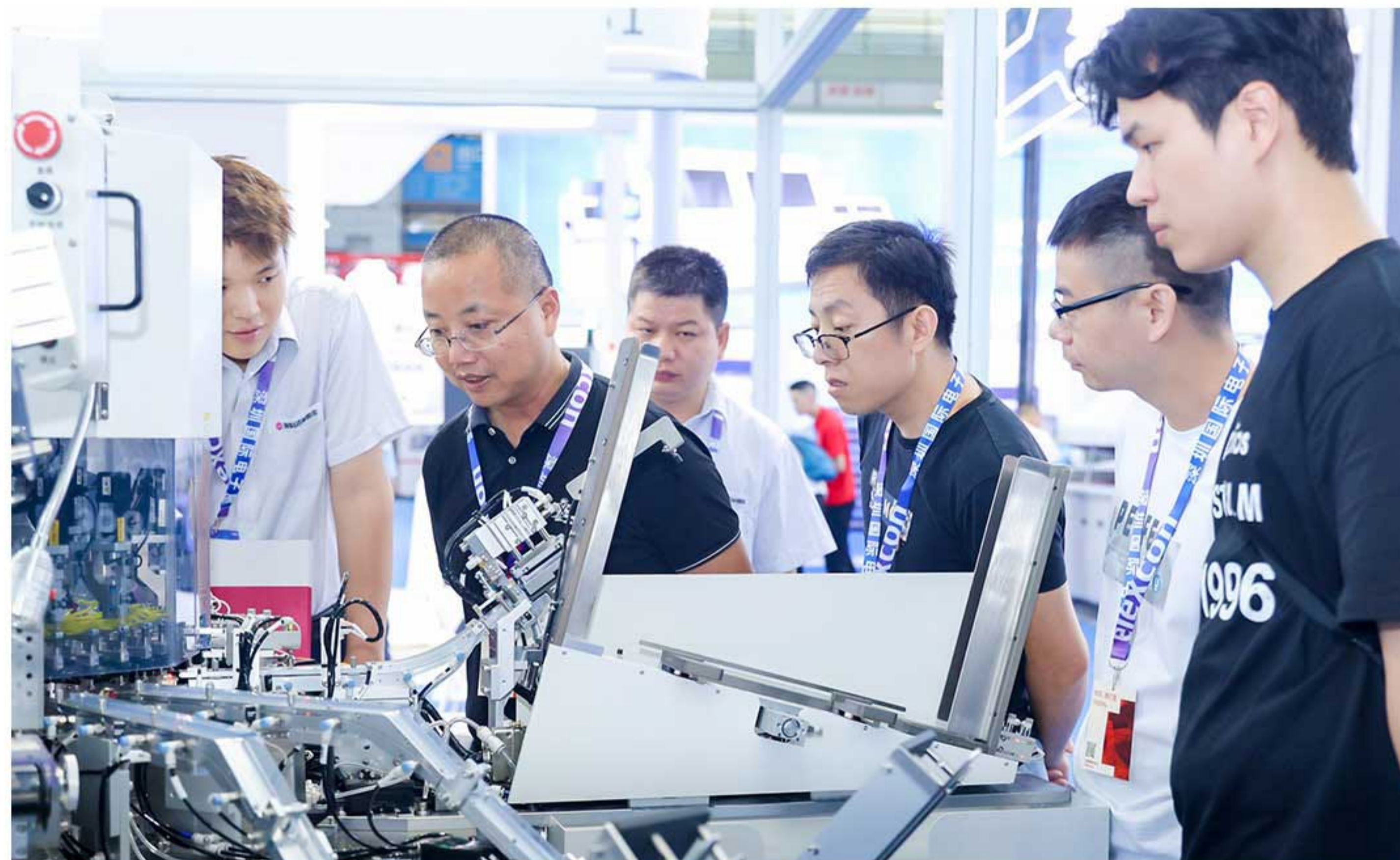
### 中山大洋技术部 吴志刚

作为这次elexcon深圳国际电子展的特邀嘉宾，见到了很多国产化存储芯片的供应商，收获颇丰，期待后续能有更深入的交流。当然，不止有存储芯片，也有AI计算卡，边缘计算等先进的技术厂家参展。能够看到在硬件这块国内公司的成长，在硬件模组，方案这方面也见识到了很多优秀的公司。感谢主办方提供这样一个机会，能够让各家公司，供应商充分交流学习，希望后续能够继续参加类似的活动。

### 联想集团 陈松豪

本次作为参展观众参加了elexcon深圳国际电子展展会，主要参观了1号馆和9号馆 在1号馆看到很多优秀的国产芯片供应商，涉及主动器件，被动器件了解他们在汽车电子这一块新的发展和方向，并且在9号馆也了解到SIP封装制程的更多的内容和相关的设备，在现场的参观以及论坛学到了很多，希望再有机会参加elexcon2024深圳国际电子展。

### 富士康科技集团



## 部分买家企业

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 富士康科技集团           | 环旭电子股份有限公司      |
| 比亚迪电子（国际）有限公司     | TCL科技集团股份有限公司   |
| 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 索尼              |
| 中兴通讯股份有限公司        | 深圳市英威腾电气股份有限公司  |
| 东莞铭普光磁股份有限公司      | 深圳麦格米特电气股份有限公司  |
| vivo维沃移动通信有限公司    | 闻泰科技股份有限公司      |
| 深圳市大族机器人有限公司      | 长城开发科技股份有限公司    |
| 华为技术有限公司          | 安森美半导体          |
| OPPO广东移动通信有限公司    | 深圳赛意法微电子有限公司    |
| 沛顿科技（深圳）有限公司      | 科大讯飞股份有限公司      |
| 深圳拓邦股份有限公司        | HONOR荣耀         |
| 联想集团有限公司          | 立讯精密工业股份有限公司    |
| 美的集团有限公司          | 深圳市正浩创新科技股份有限公司 |
| 深圳嘉立创科技集团股份有限公司   | 惠州三华工业有限公司      |
| 小米科技有限责任公司        | 苏州锐杰微科技集团有限公司   |
| 士兰微电子股份有限公司       | 安世半导体(中国)有限公司   |
| 江苏长电科技股份有限公司      | 华润微电子           |
| 长鑫存储技术有限公司        | 通富微电子股份有限公司     |





### 同期重磅高峰论坛

20+场高峰论坛 300+行业大咖 11,345名专业听众

### 部分重磅演讲嘉宾



凌峰  
创始人/CEO  
芯和半导体



戴伟民博士  
创始人/董事长兼总裁  
芯原股份



吴政达博士  
总监  
三星电子



DR. DEBENDRA DAS SHARMA  
UCLE™联盟主席/英特尔高级研究员  
英特尔内存和I/O技术部门联席总经理



刘志农  
执行副总裁  
紫光展锐(上海)科技有限公司



刘鹏  
高级首席工程师  
长鑫存储



祝俊东  
产品及解决方案副总裁  
奇异摩尔(上海)集成电路设计有限公司



孙蓉  
中国科学院深圳先进技术研究院材料所所长  
深圳先进电子材料国际创新研究院院长



陈光雄  
资深副总经理  
日月光中坭工程发展中心



林挺宇  
首席科学家  
广东省智能装备与系统集成创新中心



刘国友  
中车科学家  
株洲中车时代半导体有限公司



罗海辉  
中车时代半导体总经理  
株洲中车时代半导体有限公司



龙世兵  
教授/微电子学院执行院长  
中国科学技术大学



徐科  
副所长  
中国科学院苏州纳米技术与山东大学新一代半导体材料研究院纳米仿生研究所



徐现刚  
教授/研究院主任  
华南理工大学  
计算机科学与工程学院



陈源明  
董事长  
轩田科技



何小庆  
嵌入式系统联谊会秘书长



林金龙  
教授  
北京大学软件与微电子学院



毕盛  
副教授  
华南理工大学  
计算机科学与工程学院



赵地  
副研究员  
中国科学院计算技术研究所



张进成  
教授/副校长  
西安电子科技大学



李波  
中导光电董事长  
中导光电设备股份有限公司



袁俊博士  
湖北九峰山实验室功率器件负责人  
碳化硅首席专家  
九峰山实验室



龚先定  
中国区市场拓展资深经理  
安世半导体



张清纯  
董事长 CTO  
复旦大学特聘教授(博导)  
清纯半导体(宁波)有限公司



裴轶  
副总裁  
苏州能讯高能半导体有限公司



吴周令  
首席科学家  
合肥知常光电科技有限公司



刘建利  
无线射频总工  
中兴通讯股份有限公司

766人

深圳国际物联网技术创新与应用大会

2709人

第七届中国系统封装大会深圳站

337人

第五届深圳国际智能座舱与自动驾驶创新新技术论坛

1290人

第五届中国嵌入式技术大会

1531人

深圳国际第三代半导体与应用论坛

### 演讲嘉宾评语

随着算力需求的爆炸性增长，以Chiplet、异构集成为核心的先进封装技术，已经成为集成电路发展的关键路径。本届系统级封装大会以Chiplet实现为主题，覆盖了国内Chiplet生态圈的各个环节和头部厂商，从设计和制造两极深度洞察Chiplet的市场需求和技术趋势。我们期待继续以系统级封装大会这个平台，助力国内Chiplet行业的成熟和成功。

芯和半导体 创始人/CEO 凌峰

首次参加《深圳国际第三代半导体与应用论坛》非常专业的研讨会，聚焦行业上下产业为专业人士搭建了一个非常好的技术交流平台展，效果出乎预料，同期论坛活动精彩纷呈，非常成功！

合肥知常光电 首席科学家 吴周令

展会和论坛人气都很旺，非常感谢电子展给至信微提供了一个自我展示的机会，为大家提供了一个专业的行业交流平台，并在供需之间构建了友谊的桥梁。

深圳至信微 销售总监 沈斌



360°全方位宣传 精准触达核心人群

120+家行业媒体、综合媒体及行业KOL的广泛宣传和媒体曝光

800,000+曝光量



\*以上为部分合作媒体，排名不分先后

## 社交媒体



官方微信公众号

170,000+活跃专业粉丝

数字社群更加精准传递  
实现品牌曝光的最大化



官方企业微信

2,500+名业界专业人士

汇聚行业内决策者  
专家和领袖



官方小程序

15,000+总访问量

便捷的信息获取渠道  
提升数字化宣传的领先地位





# elexcon

深圳国际电子展



集成电路 | 嵌入式系统 | 电源/功率 | 无源器件 | OSAT封装服务

Chiplet异构集成产业链专区 | 3D IC设计/EDA工具 | IC载板

先进材料 | 半导体制造专用设备

# 2024

2024年8月21-23日  
深圳会展中心·福田

## 展位火热预定中

电话：0755-88311535

邮箱：elexcon.sales@informa.com

[www.elexcon.com](http://www.elexcon.com)



扫码关注 了解更多